

# The elements of innovation

# SEMICON<sup>®</sup> Japan 2011

註冊受理中!!

👉 [www.semiconjapan.org](http://www.semiconjapan.org)



世界最大規模的半導體製造裝置和材料相關國際性展會

## SEMICON Japan 2011

12月7日(星期三)-9日(星期五) 10:00-17:00 (免費入場)

幕張國際展覽中心(1~8 展廳, 國際會議中心)

贊助(預計): 美國商務部 千葉縣 一般社團法人電子資訊技術產業協會(JEITA)

社團法人日本半導體製造裝置協會(SEAJ)

公益社團法人應用物理學會 社團法人電子封裝學會

特定非營利活動法人LED 照明推進協會(JLEDS)

社團法人日本半導體風險企業協會(JASVA) 日本液晶學會(JLCS)

如果您不是日本居民, 敬請于到達現場時前往“海外登記處”獲取您的入場證。  
請隨身攜帶一份確認電子郵件。

SEMICON Japan 2011 白金贊助商

**Canon**

Canon Marketing Japan Inc.



**TOKYO ELECTRON**

## 值此 SEMICON Japan 2011 召開之際

### SEMICON Japan 推進委員會與主辦方致辭



**SEMICON Japan**  
推進委員會委員長  
東京 Electron 株式  
會社  
董事副會長  
**常石哲男**



**SEMI**  
日本  
代表  
**中川洋一**

#### 爲了重建和持續性發展

首先向在東日本大地震中受災的各位表達我衷心的慰問。

此次地震災害給世界的工業生產帶來了巨大影響，同時也出其不意地讓大家認識到日本在全球供應鏈中承擔的重要角色。半導體產業也出現了重要材料的供應危機，但在各個公司的努力與來自內外的溫暖支援之下，取得了迅速恢復的成果，向全世界展示了日本供應鏈強大的回復力。

第 35 次召開的 SEMICON Japan 2011，向全世界傳遞日本半導體依然發展良好的訊息，在各位的支援下，有來自世界各國約 1000 家企業參展，我們相關工作人員都感到非常高興。此外，今年在東北展館東北各縣的企業也將參展。

半導體以及相關產業，是建設未來持續性發展社會的技術源泉。SEMI Japan 2011 將在“新一代技術展館”集中展示這些未來技術，傳遞開創半導體未來的尖端資訊。

此外，半導體生產中心正逐漸轉向亞洲，在佔據全球生產能力 3/4 的情況下，亞洲圈內商務交流的重要性也日漸凸顯。今年的 SEMI Japan 將通過“Power of Asia”爲共同記事本的基調演講、展館、懇談會、研討會，爲大家提供活躍的交流平臺。

SEMI Japan 爲了推動半導體產業的進一步發展，除了展會之外，還提供以 STS 爲首的技術研討會、推動生產技術國際標準化的標準化會議，面向學生的項目等各項豐富的活動。衷心歡迎各位的光臨。

### 參觀人員幫助管道：展位嚮導（展位搜索），官方網站連結 [www.semiconjapan.org](http://www.semiconjapan.org)

可通過輸入參展企業名稱、產品目錄和關鍵字等查找目標展位的位置。便於您在參觀之前進行準備。（10 月上旬後開通）  
※現場請至“展位搜索台”，可使用展位嚮導。

#### 1 NEW REAL DEMO 標誌

在展位嚮導上通過如下標誌進行嚮導。

**NEW**：SEMICON Japan 2011 上展示首次展出的新產品和新技術的展位  
**REAL**：進行實體設備、實物展示的展位  
**DEMO**：通過新產品、新技術的實體設備進行現場演示的展位。

#### 2 新產品、新技術現場演示一覽

便於一覽展示新產品、實體設備和實物的展位和進行現場演示的展位。

#### 3 新產品、新技術展覽區

在展會召開前便能獲取各參展企業的新產品和新技術的資訊。可以流覽新產品的介紹文字和照片。

#### 4 推薦搜索關鍵字

LED、OLED、有機元件、納米壓印、柔性電路板、功率半導體、EUV、450mm、液晶、PV、3D、納米技術、非矽、TSV

## 本展會的特色

### the elements of innovation

SEMICON Japan 聚集了半導體製造相關的主要國內外裝置材料廠商。展會會場集中展示新技術、新產品以及實體設備和實物。會議樓以召開各類豐富的半導體技術研討會以及國際會議爲主。在這裡，您可以親身感受到與半導體生產相關的必要技術、技術革新以及未來。請一定要來參觀！

#### SEMICON Japan 的三大亮點！

##### 亮點 1 調查探尋，發現更多

#### 通過新產品、新技術瞭解時代潮流

各參展企業通過“SEMICON Japan 發佈會”進行新產品新技術的發佈，並展示新的解決方案及其應對新時代的優勢。更有“新一代技術展館”“展商研討會”、“展商推廣會”等眾多項目，可以瞭解到更加詳細更加深入的產品資訊。從微型化、低成本、環保等關鍵字中，可窺探半導體行業的未來。

##### 亮點 2 親眼所見，親身感受

現場設備演示，讓您體驗真實感受  
參展企業將以實體設備和實物爲中心進行展示，同時還會進行現場演示。並且還能與技術人員進行探討，體驗到通過網路和商品手冊無法獲得的感受。親自接觸這些只有親身到 SEMICON Japan 現場才能得到的最先進的最新資訊，並把它們轉換爲自己的知識帶回去吧。  
“親眼所見，調查探尋”從“展位嚮導”開始

##### 亮點 3 參與討論，多方交流

各種豐富的項目和活動，讓您把握未來動向  
通過開展 SEMI 技術研討會（STS）等種類繁多的豐富活動，讓整個半導體行業一起來參與探討。此外，還提供了行業標準的討論平臺，通過 SEMI 標準會議、標準相關研討會等，掌握半導體行業裝置、材料的標準化動向。

#### 關於 SEMICON Japan 2011 電力供應

##### 引進自然能源

SEMICON Japan 2011 中，通過購買綠色電力，將展會中使用的部分電力（5000kWh）轉換爲自然能源。



什麼是 SEMI：SEMI（國際半導體設備材料產業協會）是全球性的產業協會，致力於促進微電子、平板顯示器、太陽能發電產業的設備、材料、相關服務的產業供應鏈的發展。目前已經在全球 14 個微電子和平板顯示器的基地設置了辦事處，爲全球約 1800 家會員單位服務。SEMI 通過開展展覽會、國際交流、提出建議、市場統計調查、國際標準、環境保護、安全衛生、人材培養等各種各樣的活動，促進行業整體健康發展。

## SEMICON Japan 的豐富企劃

### 新一代技術展館 (5、6號展廳)

SEMI 從引導未來半導體產業的尖端技術中，挑選最引人注目的最熱技術內容，在新一代技術展館中設立展區。每個主題都會有先進企業、研究機關、大學等齊聚一堂，向全球傳遞最新資訊。此外，同時設立的展館推廣論壇上，新一代技術展館的參展商將進行技術發表（可免費聽講）。

#### LED/OLED 展區

該展區集合了 LED、HBLED、有機 EL 等最先進的發光元件。其中還彙集了生產裝置和材料、檢查、測定、應用軟體等相關的核心機構。

#### 三維封裝展區

展示了 SiP、MCM、MCP 等三維封裝以及正當熱門的矽穿孔技術 (TSV)。彙集了從生產技術到材料、測定檢查應用軟體等相關的核心機構。

### 二手設備展館 (8 號展廳)

在以各種 ASSP、車載半導體、功率元件為中心，200mm 以下的生產設備需求加強的背景下，且為了減少設備投資和生產線投產時間，對二手設備的需求也在增長。請關注二手設備展館，將滿足您這方面的需求。此外，同時設立的展館推廣論壇上，參展商將進行技術發表（可免費聽講）。

### 東北展館 (2 號展廳) 創造出東北地區閃光點的企業齊聚一堂

由正在從東日本大地震中恢復重建的東北六縣 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) 共同參展。自治體與企業團結一心，為災後重建而努力。  
\*SEMI 對東北展館進行贊助。

#### 印刷電子展區

在此可以看到 PV、LED 以及 LSI 等作為可廣泛應用在各類領域裡的新一代元件圖案化技術而備受矚目的技術。彙集了納米壓印技術、柔性電路板技術等從生產技術到材料、測定檢查應用軟體等相關的核心機構。

### 學會/團體特別展區 (5、6號展館)

#### 應用物理學會展區

此展區介紹的是長年來在半導體產業的各種先進技術開發上取得巨大成果的應用物理學會。展示屏將從應用物理學會製作的跨越多領域的學術藍圖中，挑選矽技術、有機電子、MEMS 等領域內容，通過展示板為觀眾進行介紹，同時就這些領域的相關革新技術的發展與對風險商務的挑戰召開演講會。

▶ <展會會場 1 主講壇>將舉行免費演講會

#### 電子封裝學會展區

社團法人電子封裝學會 (JIEP) 是日本國內最大的提供電子相關研究發表報告會、培訓、出版、資訊交換的學會。在 SEMICON Japan 2011 上，將為大家介紹今後承擔電子產業重任的半導體封裝技術的最新資訊和未來動向。

▶ <展會會場 1 主講壇>將舉行免費演講會

#### LED 照明推進協會展區

作為日本國內最大的進行 LED 照明領域推廣普及的團體，特定非營利活動法人 LED 照明推進協會通過展示板介紹 LED 照明相關技術的最新動向。

#### 學生企劃

##### 去 SEMICON 吧！-招聘會- (免費參加)

本活動以 2013 年畢業生為物件，以說明全行業網羅新生，與參展商進行人材對接為目的。通過參觀展會的展位，參加企業研討會，在各企業展位上與人事負責人進行面談，提早向學生進行宣傳，為企業獲得對行業有熱情的優秀人材提供極為有效的平臺。

時間：12 月 8 日 (星期四) 12:30-17:00 地點：國際會議廳 2F 國際廳

#### ★網站預約制

##### 先行召開“去 SEMICON 吧！先行研討會”：

時間 10 月 20 日 (星期三)、11 月 18 日 (星期四) 地點 SEMICON Japan 會議室 (東京，市之穀)

#### 印刷電子展區

在此可以看到 PV、LED 以及 LSI 等作為可廣泛應用在各類領域裡的新一代元件圖案化技術而備受矚目的技術。彙集了納米壓印技術、柔性電路板技術等從生產技術到材料、測定檢查應用軟體等相關的核心機構。

#### MEMS 展區

本展區向您展示近年來持續飛速發展的 MEMS 技術。在此彙集了從生產技術到材料、測定檢查應用軟體等相關的核心機構。

#### 創新風險展區

此展區將介紹受到大家關注的新技術。請將目光投向“納米技術”、“功率半導體”、“新一代生產工程”、“EUV”、“新技術”、“新測定技術”、“450nm 相關技術”、“新一代光刻技術”等為主題的最先進技術。在這裡將誕生下一個王牌。

### Power of Asia 展館 (8 號展廳)

以建立半導體製造相關的日本與亞洲各國間的雙贏關係，活用只有 SEMI 才有的全球網路為目的，新的展館誕生了。

#### 亞洲製造服務展區

活躍於晶圓廠、分包、測試等領域的企業將會參展。提供與跨越製造領域框架與國界的全新技术進行接觸的平臺。

#### 亞洲零部件供應商展區

將有優秀的亞洲零部件供應企業參展。

#### 亞洲商務發展展區

該展區有亞洲各國的企業招商機構與自治體的對外展位。為參展企業與參觀企業進軍海外專業提供資訊交流的有效平臺。

### The 高專@SEMICON Japan 2011 (SEMI 合作企劃)

該企劃由 SEMICON Japan 的參展企業在自己的展位處設置特別展位，為工業高等高中、高等專門學校的學生提供發表研究成果的平臺，加深學生對半導體行業的理解。展示出充滿年輕工程師們的想法的技術和研究成果。

### 傳遞最前線資訊！！特設推廣論壇

#### 展會會場展廳 1 主講壇 免費聽講★網站預約制

##### 12 月 7 日 (星期三)

11:30-12:20 STS 焦點演講會：封裝

12:30-13:20 STS 焦點演講會：OLED

13:30-16:30 電子封裝學會特別研討會 -封裝技術的最新動向-

##### 12 月 8 日 (星期四)

10:30-12:20 STS 衛星：醫療與電子的融合 -預防醫療領域中電子技術的應用

12:30-13:20 STS 焦點演講：微系統/MEMS

13:30-16:40 應用物理學會特別研討會 -學術藍圖與技術革新的挑戰

##### 12 月 9 日 (星期五)

10:30-12:20 STS 衛星：DFM -以易製造性、提高生產性為目的的晶片設計、工藝設計、製造設計-

12:30-13:20 STS 焦點演講：印刷電子

13:30-16:20 日本液晶學會特別研討會 -“液晶”所夢想的最前沿技術-

#### 展會會場展廳 6 參展企業推廣演講

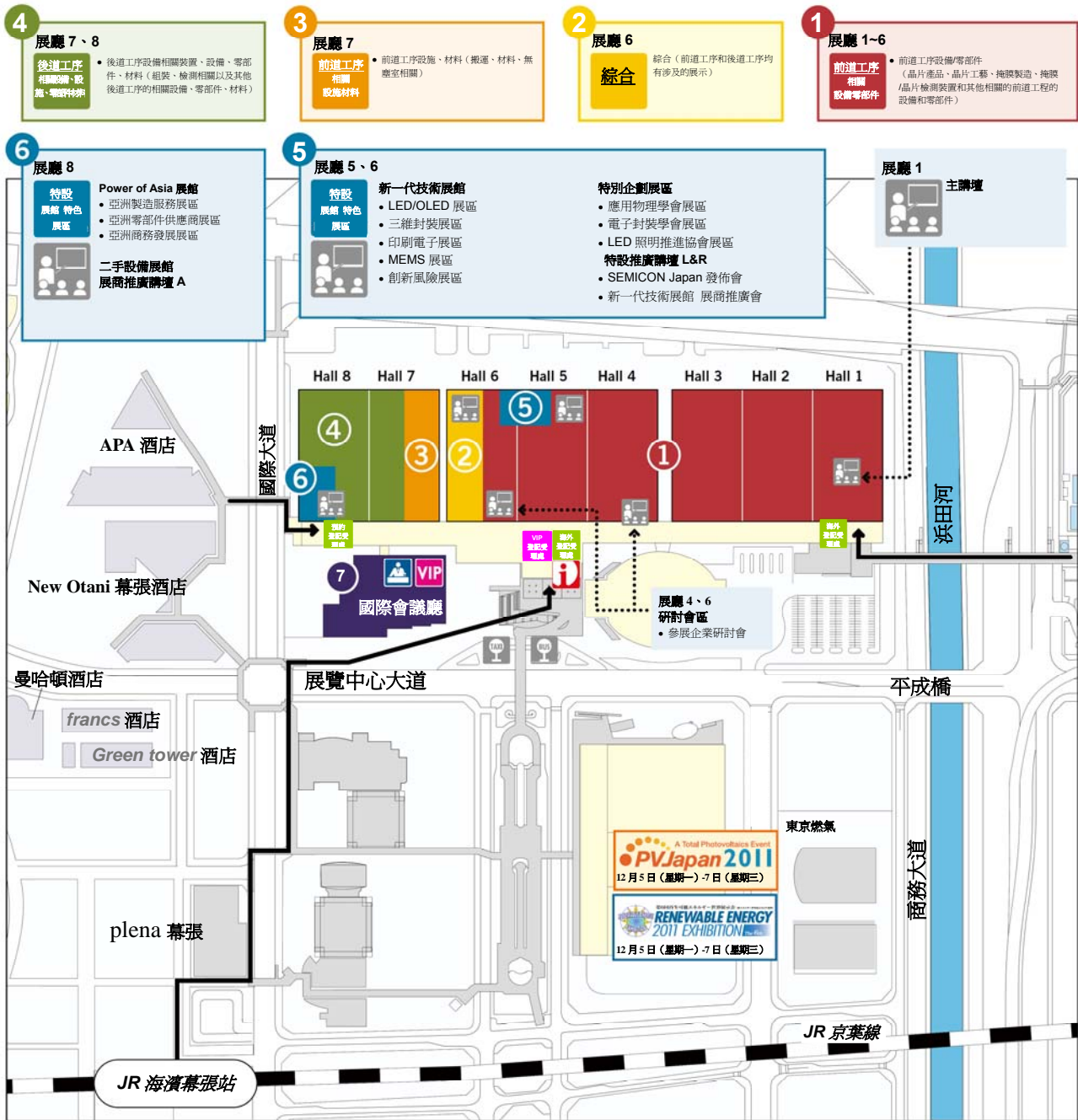
5-6 號展廳：由參展企業就新研發產品、最新技術進行推介 (SEMICON Japan 發佈會)。此外在同一講壇，將連續數日由新一代技術展館的參展企業舉辦推介活動。

8 號展廳：由二手設備展館以及 Power of Asia 展館的參展企業連續數日舉辦推介活動。

詳細情況請參閱第 9 頁。

\* 除推廣論壇外，4、6號展廳的研討室也將連續數日由參展企業舉行新產品、最新技術、開發理念等研討會。詳細情況請參閱第9頁。

# 幕張國際展覽中心會場指南



- 7 國際會議廳**
- 開幕式
  - 開幕主題演講
  - 開幕式
  - SEMI 技術研討會 (STS) 2011
  - 重建特別會議
  - 二手半導體製造裝置研討會
  - SEMI 市場研討會
  - 第 12 屆地球環境研討會
  - 450nm 晶片相關 SEMI 標準解說研討會
  - 地震對策與 SEMI 安全指南
  - SEMI 負責人招待會
  - 交流晚宴 亞洲之夜
  - SEMI 標準頒發儀式友誼招待會
  - SEMI 標準化會議
  - 去 SEMICON 吧！招待會

**圖例**

|                  |                           |                          |                           |             |        |
|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| <b>Front-end</b> | Front-end Process & Parts | <b>Special Pavilions</b> | SEMI Special Feature Area | <b>i</b>    | 諮詢台    |
| <b>研討會與發布會</b>   | 當日受理                      | <b>預約登記受理處</b>           | 預約登記受理                    | <b>BUS</b>  | 班車乘車處  |
| <b>當日登記受理處</b>   | 當日登記受理                    | <b>VIP</b>               | VIP 受理                    | <b>TAXI</b> | 計程車乘車處 |
| <b>海外登記受理處</b>   | 海外登記受理處                   | <b>研討會與發布會</b>           | 研討會與發布會 當日受理              |             |        |

## 研討會與招待會指南 (講師敬稱略)

### 開幕主題演講

提供日英同聲傳譯

#### -Power of Asia

時間 ● 12月7日(星期三) 9:30-12:05

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 國際廳

免費聽講★網站預約制

在展會第一天將進行開幕活動。無論是整個經濟還是電子領域，亞洲在全球的影響力日益擴大。本會議中，將由亞洲各地區業界的一流管理人員上臺，就今後如何在持續性發展之中推動亞洲各國商業發展，如何建立合作互利關係進行展望。

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 9:30-9:50   | 開幕式   |  |
| 10:00-10:05 | 會議簡介  |  |
| 10:05-10:35 | 面向智慧社會的變革 電子半導體專業 -歷經地震災後重建   |   |
|             | 瑞薩電子株式會社<br>董事長兼總經理 赤尾泰   |  |
| 10:35-11:05 | Role of Product Development in Sustainable Profitable Growth at Tata Motors                               |   |
|             | Tata Motors<br>Head, Vehicle Performance & CAE<br>Ashok Joshi   |  |
| 11:05-11:35 | Business Strategy and Global Collaboration  |   |
|             | GLOBALFOUNDRIES Singapore<br>Senior Vice President,<br>200mm Business Unit & General Manager<br>Raj Kumar |  |
| 11:35-12:05 | The New Dynamics of Semiconductor Business  |  |
|             | ASE<br>Director, Chief Operating Officer<br>Tien Wu   |  |

### 重建特別會議

#### -供應鏈與全球化合作-

時間 ● 12月8日(星期四) 13:30-16:15

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 國際廳

專案主持人 ● HIS iSuppli Japan (株式會社) 副總經理/主席分析師 / Japan Research 南川明

免費聽講★網站預約制

伴隨著東日本大地震取得災後重建的真正性進展，必須通過開發、提供供應鏈風險回避方案與高穩定性、高機能產品，以挽回客戶的信任。就通過本次地震凸顯出的供應鏈問題與解決措施進行探討，就今後的發展戰略和全球規模的協作方式進行展望。

|             |                         |  |
|-------------|-------------------------|--|
| 13:30-13:45 | 會議開場：地震和日元升值引起的產業鏈變化    | HIS iSuppli Japan (株式會社) 副總經理/主席分析師 / Japan Research 南川明 |
| 13:45-14:15 | 產業鏈/卓越性                 | 英特爾 (株式會社) 董事長兼總經理 吉田和正                                  |
| 14:15-14:45 | 醫療器械與日本醫療器械產業概要         | (株式會社) 飛利浦電子日本<br>總經理室 行政/相關工業會擔當部長 村瀨昌男                 |
| 14:45-15:15 | 東日本大地震中凸顯出的日產產業鏈問題與解決對策 | 日產汽車 (株式會社) 生產企劃部部長 渡邊雅廣                                 |
| 15:15-15:45 | 災後重建與穩定供應的工作            | 日立化成工業 (株式會社) 機能材料事業本部 電子材料事業部 事業部長 森島浩之                 |
| 15:45-16:15 | 在建立全球化產業鏈中巴西能做的事情       | 巴西大使館  |

### 電子封裝學會特別研討會

#### -封裝技術的最新動向-

時間 ● 12月7日(星期三) 13:30-16:30 地點 ● 幕張國際展覽中心 1號廳 主講壇

免費聽講★網站預約制

### 應用物理學會特別研討會

#### -學術藍圖與技術革新的挑戰-

時間 ● 12月8日(星期四) 13:30-16:40 地點 ● 幕張國際展覽中心 1號廳 主講壇

免費聽講★網站預約制

### 日本液晶學會特別研討會

#### -“液晶”所夢想的最前沿技術-

時間 ● 12月9日(星期五) 13:30-16:20 地點 ● 幕張國際展覽中心 1號廳 主講壇

免費聽講★網站預約制

### SEMI 技術研討會 (STS) 2011 30 周年企劃

SEMI 技術研討會 (STS) 上，除在國際會議廳召開的收費會議 (1~11) 外，為紀念 30 周年，還將在 1 號廳主講壇召開免費 STS 衛星會議與 STS 焦點演講會。

### STS 衛星會議 醫療與電子的融合

#### -預防醫療領域中電子技術可做的事-

時間 ● 12月8日(星期四) 10:30-12:30 地點 ● 幕張國際展覽中心 1號廳 主講壇

會議主持人 ● 應用材料日本 (株式會社) 堀岡啓治  
東京電子 (株式會社) 柏木勇作/富士通半導體 (株式會社) 奈良安雄  
免費聽講★網站預約制

隨著少子高齡化的發展，醫療費、看護費的總額預計在 2025 年達到去年兩倍的 90 兆日元左右，如果制定並實行抑制措施成為重要課題。在對策上出現了將重點從原先的在診斷治療中心進行醫療轉向保持健康和預防之上，特別是人們通過應用電子技術，創造出新的產業方面的期待正在提高。

#### 主要內容

- 電子產業對健康、預防等新市場的貢獻
- 使用超聲波圖像裝置開拓健康新市場的事例

### STS 衛星會議 DFM

#### -以易製造性、提高生產性為目的的晶片設計、工藝設計、製造設計-

時間 ● 12月9日(星期五) 10:30-12:00 地點 ● 幕張國際展覽中心 1號廳 主講壇

協辦 ● JEITA DFM 小委員會

會議主持人 ● (株式會社) 東芝 佐藤隆/瑞薩電子 (株式會社) 吉岡信行  
免費聽講★網站預約制

#### 主要內容

- 傳統晶片設計 DFM、晶圓廠 DFM ● 基於電腦技術的工藝設計、製造設計
- 虛擬 Fab、工藝 Sim ● APC/AEC

### STS 焦點演講會

地點 ● 幕張國際展覽中心 1號廳 主講壇 免費聽講★網站預約制

由行業內專家對熱門技術領域進行展望。請一定前來參加。  
12月7日(星期三) 11:30-12:20 封裝 12:30-13:20 OLED  
12月8日(星期四) 12:30-13:20 微系統·MEMS  
12月9日(星期五) 12:30-13:20 印刷電子

#### 主要內容

- 由半導體技術藍圖看技術總體趨勢
- 各工作小組報告 (15 件)

## 研討會與招待會嚮導 (講師敬稱略)

### SEMI技術研討會 (STS) 2011

時間 ● 12月7日(星期三)~9日(星期五) 地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳

STS計畫委員會 委員長 ● (株式會社)東芝半導體&存儲公司  
生產性改善推進部 環境企劃推進負責人 部長 依田孝

參加費用(不含消費稅) ● 11月25日(五)前 11月26日(六)後  
含資料預先下載

參加1場會議 21,000 日元 25,000 日元

#### 優惠套餐

2場會議優惠套餐 原 42,000 日元 原 50,000 日元  
\*套餐請至網站確認。 34,000 日元 42,000 日元

3天全部11場會議套餐 原 105,000 日元 原 125,000 日元  
72,000 日元 90,000 日元

只購買教材 10,000 日元

(收錄 STS 全部 11 場會議資料)

\*12 月中旬以後按順序通知下載用網站連結。

\*關於是否有翻譯的情況請參閱各會議的介紹。

#### 會議 1 測試

提供日英同聲傳譯

-講述測試技術的今天與明天!成本與品質管制-

時間 ● 12月7日(星期三)14:00-17:35

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 3F 301 會議室

會議主持人 ● Teradyne (株式會社) 梅永敬/ (株式會社) 東芝 浦田浩司

伴隨著設備的高性能化、高機能化,測試成本呈現上升趨勢,同時難以避免降低生產這一市場需求。此會議將以同時保證高品質與成本降低為目的,綜合設計簡易化、測定技術等各種技術要素,介紹最佳策略。除了從亞洲 OSAT 聘請講師講解“成本”與“品質”的定位之外,進行發表的企業還將通過顯示幕研討會上進行熱烈的意見交流。

#### 主要內容

- 測試成本
- 高品質/高可靠性測定技術
- 測定簡易化設計
- 分包測試戰略

#### 會議 2 前沿設備

提供日英同聲傳譯

-運用新材料的新一代設備-

時間 ● 12月8日(星期四)10:00-13:00

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 國際會議室

會議主持人 ● Applied Materials 日本 (株式會社) 堀岡啓治  
MEC 東鄉光洋/富士通半導體 (株式會社) 三穀純一

對於 CMOS 電晶體,進入納米領域,通過微型化技術提高性能變得較為困難。在本會議上,聚集了各類新材料半導體方面的專家,就 20nm 世代之後的面向 MoreMoore 的最新半導體技術進行介紹。

#### 主要內容

- 單層石墨、炭納米設備的展望、高速光回路
- 自旋電子的展望
- Ge,III-V CMOS 設備
- FinFET 設備與 FinFET 納米線

#### 會議 3 前沿存放裝置/工藝

提供日英同聲傳譯

-非易失性記憶體的工藝、材料現狀與技術課題-

時間 ● 12月8日(星期四)14:00-17:20

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 201 會議室

會議主持人 ● (株式會社) ULVAC 門倉好之/ (株式會社) 在原製作所 小野澤益信  
索尼 (株式會社) 木村秀樹

由於來自智慧手機等數位末端的旺盛需求,以及來自承擔雲計算重任的基礎設備的技術性需要,可以預計非易失性記憶體今後將得到進一步發展。在本會議上,將從最新設備、工藝要素技術的角度出發,針對直追已逼近技術性極限的 NAND 記憶體的新一代非易失性記憶體進行說明。

#### 主要內容

PCRAM ReRAM

非易失性記憶體的成膜技術動向 非易失性記憶體的 RIE 技術動向

### SEMI技術研討會 (STS) 2011

#### 會議 4 封裝

提供日英同聲傳譯

-終於誕生的應用軟體:實現調整傳送的封裝技術-

時間 ● 12月8日(星期四)10:00-13:20

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 201 會議室

會議主持人 ● 佳能機械 (株式會社) 高須誠一/新光電氣工業 (株式會社) 竹內之治  
(株式會社) 東芝 田窪知章

隨著設備小型化、高功能化的發展,在對半導體性能要求越來越高的當今,封裝技術為終於可以稱得上進入實用化階段的高速傳送的實現作出了貢獻,在本會議上,將由活躍在應用軟體、設備、製造、R&D 各領域第一線的講師們,就這一封裝技術進行演講。

#### 主要內容

- 金士頓、東北大學的模組高速傳送
- 英特爾的封裝戰略
- 富士通的超級電腦相關封裝技術
- TSMC 的矽轉接板技術

#### 會議 5 TSV

提供日英同聲傳譯

-歡迎來到連接未來的三維封裝世界-

時間 ● 12月8日(星期四)14:00-17:20

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 國際會議室

會議主持人 ● (株式會社) 東芝 依田孝/佳能機械 (株式會社) 高須誠一

索尼 (株式會社) 木村秀樹/ (株式會社) 東芝 浦田浩司/  
東京應化工業 (株式會社) 種市順昭

本會議為企劃 SEMI 技術研討會(STS)的前道工程、封裝、測試和 MEMS 全部 4 個委員會開展的聯合企劃。通過運用 TSV 的三維集成技術以實現 More Than Moore 的活動日益活躍。在本會議中,將從市場、研究開發動向、應用以及測試領域對 TSV 技術進行討論,並展望其未來。

#### 主要內容

- TSV 的市場動向
- IMEC、ASET 的 TSV 開展
- TSV 矽轉接板
- TSV 邊界掃描

#### 會議 6 微系統/MEMS (1)

提供日英同聲傳譯

-全球 MEMS 新潮流-

時間 ● 12月9日(星期五)10:00-13:00

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 國際會議室

會議主持人 ● 東北大學 江刺正喜/東京電子 (株式會社) 圓城寺啓一

由海外企業、研究機關進行總共八項發表。其中包括來自亞洲的晶圓廠、封裝、R&D 三項,來自北美的光子學二項,耐環境 MEMS、消費電子相關四項,以及來自歐洲的市場動向一項。

#### 主要內容

- 臺灣 MEMS 晶圓廠、中國 R&D
- 封裝
- MEMS 應用軟體(光子學、耐環境、消費電子)
- 市場動向與話題

#### 會議 7 微系統/MEMS (2)

-向全球擴張的日本 MEMS-

時間 ● 12月9日(星期五)14:00-17:00

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 3F 301 會議室

會議主持人 ● 東北大學 江刺正喜/東京電子 (株式會社) 圓城寺啓一

由日本國內企業、大學進行總共八項發表。其中包括來自企業的生物晶片、矽麥克風、紅外線感測器、氣體感測器四項,來自大學的壓電元件、開關、無線感測器,以及來自調查公司的市場分析一項。

#### 主要內容

- DNA 晶片
- 各類感測器(紅外線、氣體、無線)
- 矽麥克風、MEMS
- 市場分析與預測
- 開關、RF-MEMS

## 研討會與招待會嚮導 (講師敬稱略)

### SEMI技術研討會 (STS) 2011

#### 會議 8 微光刻 (1) 提供日英同聲傳譯

- EUVL, 還是光延續壽命? 追逐光刻技術的最新動向-

時間 ● 12月9日(星期五) 10:00-13:00

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 201 會議室

會議主持人 ● 佳能(株式會社) 鈴木章義/大日本印刷(株式會社) 林直也  
(株式會社) 尼康 大和壯一/(株式會社) 日立高科技 池野昌彥

雖然新一代光刻中 EUVL 被認為是主流,但此前計畫的 2012-13 年量產實用化中還仍然面臨許多課題。作為橋樑技術的 ArF 液浸+DPL 已經實用化,但還面臨著工藝成本的課題。上午,將對以性能和成本優化為目標的光刻技術最新動向進行探討。

#### 主要內容

- EUVL 技術的最新動向
- ArF 液浸+DPL 的最新動向
- 卓越光刻技術的展望
- DSA 與 DPL 的微細化

#### 會議 9 微光刻 (2) 提供日英同聲傳譯

- Alternative Technology 與基礎架構的情況-

時間 ● 12月9日(星期五) 14:00-17:00

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 國際會議室

會議主持人 ● 佳能(株式會社) 鈴木章義/大日本印刷(株式會社) 林直也  
(株式會社) 尼康 大和壯一/(株式會社) 日立高科技 池野昌彥

雖然新一代光刻中 EUVL 被認為是主流,但此前計畫的 2012-13 年量產實用化中還仍然面臨許多課題。作為橋樑技術的 ArF 液浸+DPL 已經實用化,但還面臨著工藝成本的課題。下午,將討論作為代替技術的 ML2 等開發進展情況以及麥克風等周邊技術動向。

#### 主要內容

- ML2 技術的最新動向
- 新一代光刻膠材料
- 麥克風與周邊技術課題

#### 會議 10 LED

- 最新 LED 技術動向~高效率化要什麼時候才能實現? -

時間 ● 12月9日(星期五) 10:00-12:50

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 3F 301 會議室

協辦 ● SEMICON Japan LED/OLED 執行委員會

會議主持人 ● 下出照明諮詢 下出澄夫

近年來,人們對綠色設備的期待日益高漲,特別是 LED 作為照明和液晶屏用背光等的光源,其需求在迅速擴大。本會議將就以螢光燈 2 倍發光效率為目標的 LED 照明高效率化,以及迅速發展的 LED 技術的未來進行詳細解說。

#### 主要內容

- 市場動向
- 技術課題
- 發光效率的高效化
- 新材料動向

#### 會議 11 OLED 提供日英同聲傳譯

- 最新有機 EL 技術動向~量產技術開發的現狀與未來展望!! -

時間 ● 12月9日(星期五) 14:00-16:50

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 201 會議室

協辦 ● SEMICON Japan LED/OLED 執行委員會

會議主持人 ● 新日鐵化學(株式會社) 下浦康弘

有機 EL 除了在小型展示實現了實用化之外,作為白色照明其發光效率也與螢光燈不斷接近,今後市場擴大的期待日益高漲。在本會議中,作為為了讓日本取得該技術主動權的資訊,將對全球開發動向以及包括 RtoR 技術和塗布型在內的最新技術動向進行詳細解說。

#### 主要內容

- 開發目標與課題
- 研究開發動向
- 歐洲最新技術研究
- 塗布型工藝技術

### SEMI技術研討會 (STS) 2011

#### 第 18 屆 STS Award 頒獎儀式 免費入場

時間 ● 12月8日(星期四) 13:00-13:15

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 國際廳 A

在聽講人意見的基礎之上,由 STS 項目委員會從去年 STS2010 的所有演講會中評選出特別優秀的演講。

第 18 屆 STS Award 獲獎人

- ASE 市場與服務日本(株式會社) 植垣祥司《Cu 引線結合的挑戰》
- SII 納米技術(株式會社) 加藤心《電腦光刻時代的掩膜處理》
- ST 微電子(株式會社) 板田稔《MEMS 設備的最新動向與其應用》
- 東京電子(株式會社) 板本浩一《裝置維護今後的方向》
- 瑞薩電子(株式會社) 中村芳行《通過適應性測試提高品質降低成本》

#### 技術/商務專家

#### 國際 EHS 限制適用研討會 EHS

-環境限制動向與應對事例-

時間 ● 12月6日(星期二) 13:00-17:00

地點 ● SEMI Japan (市之穀) 大島樓 會議室

專案主持人 ● 東京電子(株式會社) 井深成仁

TÜV Rheinland 日本(株式會社) 杉田吉廣

參加費用(不含消費稅) ● 11月25日(五)前 16,000 日元/11月

26日(六)後 19,000 日元

提供預先資料下載,無翻譯

近幾年來,本會議都對世界化學物質限制規定動向進行了探討,今年除化學物質限制規定動向之外,還以影響半導體製造裝置產業界的環境限制規定全體為,對環境限制規定與應對事例進行介紹。

#### 主要內容

- 歐洲 RoHS/WEEE 修訂動向
- REACH/CLP、GHS 的現狀與課題
- 能源高效率零部件限制規定的現狀與課題(發動機限制規定等)

#### 二手半導體製造裝置研討會 提供日英同聲傳譯

-持續發展的二手市場 活用方法最前線-

時間 ● 12月7日(星期三) 10:00-13:00

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 3F 301 會議室

項目主持人 ● (株式會社) INTERTEC 佐藤和權/三井住友金融&租賃(株式會社) 下田力

參加費用(不含消費稅) ● 11月25日(五)前 21,000 日元/11月

26日(六)後 25,000 日元

提供預先資料下載

半導體行業的設備投資已經離不開二手設備。本次將由積極推動從 200mm 設備到 300mm 設備等二手設備領域投資的 Global Foundries 以及從震災影響中迅速恢復的羅姆就最近的應用事例進行介紹,並展望未來。此外,中國檢驗認證機構(CCIC)將發表當地法律規定的最新動向,並由調查公司進行二手設備市場分析。

#### 主要內容

- Global Foundries 的二手設備投資戰略
- 災後重建與二手設備的活用
- 二手設備市場報告解說
- 中國二手設備交易法規定

#### SEMI 市場研討會 提供日英同聲傳譯

-預測不透明的半導體供應市場-

時間 ● 12月7日(星期三) 14:00-17:30

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 2F 國際會議室

參加費用(不含消費稅) ● 11月25日(五)前 21,000 日元/11月

26日(六)後 25,000 日元

提供預先資料下載

世界經濟減速等預測半導體供應市場的不確定因素正在產生。另一方面,以發展中國家為中心的消費擴大和城市生活智慧化等長期性的發展值得期待。在本會議中,將由代表各領域的講師陣容對從電子機器到製造設備材料等方向進行分析與預測。此外,還將涉及受到關注的智慧電網市場的內容。

#### 主要內容

- 智慧電網市場(日本 IBM)
- 電子機器市場(HIS iSuppli)
- 半導體市場(WSTS)
- 半導體/LED 晶圓廠投資
- 半導體製造設備材料市場(SEMI)

## 研討會與招待會嚮導 (講師敬稱略)

### 技術/商務專案

#### 第 12 屆地球環境研討會

環境

-半導體產業界的能源問題與溫室氣體對策-

時間 ● 12月8日(星期四) 13:00-17:00

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 3F 302 會議室

協辦 ● 一般社團法人電子資訊技術產業協會 (JEITA)、社團法人日本半導體製造裝置協會 (SEAJ)、社團法人日本空氣淨化協會 (JACA)

會議主持人 ● 索尼 (株式會社) 北川哲也/東京電子 (株式會社) 井深成仁

參加費用 (不含消費稅) ● 11月25日(五)前 16,000 日元/11月26日(六)後 19,000 日元

提供預先資料下載,無翻譯

本研討會一直以來,對作為氣候變化對策一環的節能化與 GHG 對策進行了討論。在日本,由於東日本大地震的影響,人們對電力問題的關注進一步提高,在美國,由於 GHG 報告規則的生效,又重新引進人們對其開展重要性的關注。今年,將就能源問題與溫室氣體的焦點內容召開研討會。

#### 主要內容

- 相關業界團體 (JEITA、SEAJ、JACA、SEMI) 工作的介紹,
- GHG、節能、溫室氣體管理、CDM、綠色電力、排放權交易相關公司工作的介紹

### SEMI 標準相關項目

#### 地震對策與 SEMI 安全指南

EHS

-以 SEMI S2/S17/S26 地震對策設計以及 S12 污染去除為中心-

時間 ● 12月7日(星期三) 13:00-17:00

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 3F 302 會議室

項目主持人 ● 英特爾 (株式會社) 佐倉英俊/東京電子 (株式會社) 真比 SUBIKA

參加費用 (不含消費稅) ● 11月25日(五)前 9,000 日元/11月26日(六)後 12,000 日元

提供預先資料下載,無翻譯

SEMI S2/S26 地震對策設計之項中,以孤神淡路大地震與台中大地震中半導體工廠的受災經驗以及當時的美國 UBC 為基礎進行了講述,提供了有益資訊,但是與加入更近期的安全指南的 S17 相比,還略顯不足。另一方面,還有 S12 在東日本大地震污染去除時得到應用的報告。在本研討會中,將通過案例研究 (用戶、供應商、BCP 專門機關等) 分享震災事業來的教訓,複習現存的 SEMI 安全指南,對更有效的利用與改善進行探討。

#### 450mm 晶片相關 SEMI 標準解說研討會

450mm

時間 ● 12月9日(星期五) 13:00-16:45

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 3F 302 會議室

會議主持人 ● (株式會社) Acteon 小松省二

參加費用 (不含消費稅) ● 11月25日(五)前 16,000 日元/11月26日後 19,000 日元

提供預先資料下載,無翻譯

對 450mm 晶片相關的 SEMI 標準化的全貌進行簡單易懂的講解。除了對進行了近四年半的 SEMI 標準化活動中誕生的 450mm 晶片 (工藝/開發用) 以及硬體 (FOUP、負載埠等) 的標準進行解說,同時還將傳遞新開始進行標準開發的處理艙與運輸模組間的平臺標準等最新資訊。各講師均實際活躍在標準化活動的最前線,本研討會經過去年 2 次召開,獲得很好的評價,本次為第 3 次召開,提供所有半導體製造設備、材料領域相關人員不可錯過的內容。

SEMI 標準是在全球半導體和 FPD 製造、太陽能發電領域等被廣泛應用的業界自主標準。

從 1973 年活動開展以來,集合了全球半導體、FPD、太陽能發電等相關人員開發的 SEMI 標準,在 38 年時間裡,得到了專家的高度信賴與評價,如今該標準已在業界深深紮根。如今,已在 12 個領域出版了約 800 項 SEMI 標準。

### 交流宴會活動

#### SEMI 招待會

時間 ● 12月7日(星期三) 17:00-19:00

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 國際廳 A

參加費用 (不含消費稅) ● 18,000 日元

全球半導體廠商、設備、材料相關企業精英齊聚一堂的 SEMI 招待會。是創建全球化網路的絕好機會。

#### 交流晚宴 亞洲之夜

半導體產業對防止氣候變化的努力 -促進節能和溫室氣體對策

時間 ● 12月8日(星期四) 18:00-19:30

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 ★邀請制

以 Power of Asia 展館的參展企業、組織、機構的精英代表為主,各方友人齊聚一堂,擴大交流圈的聚會。

#### SEMI 標準頒獎儀式/聯誼會

時間 ● 12月8日(星期四) 18:00-19:30 ★網站預約制

地點 ● 幕張國際展覽中心國際會議廳 3F 301 會議室

為以日本 SEMI 標準委員為主的為推進全球 SEMI 標準活動出力的各位舉辦的招待會。同時還將對在國際標準化活動中做出貢獻的各位進行各 SEMI 標準獎項的頒獎儀式。

### SEMICON Japan 2011 標準化會議日程表

|                        |                    |               |
|------------------------|--------------------|---------------|
| 12月5日(月) 15:00-18:00   | 日本地區標準化委員會 (僅相關人員) | SEMI Japan會議室 |
| 12月6日(火) 15:00-17:00   | 液體化學委員會            | 國際會議廳102會議室   |
| 12月7日(水) 15:00-17:00   | 氣體及設備委員會           | 國際會議廳204會議室   |
| 12月8日(木) 9:00-12:00    | 度量委員會              | 國際會議廳301會議室   |
| 13:00-17:00            | 可追溯性委員會            | 國際會議廳203會議室   |
| 13:00-17:00            | 矽晶片委員會             | 國際會議廳303會議室   |
| 13:00-17:00            | 國際標準化委員會 (僅相關人員)   | 國際會議廳304會議室   |
| 12月9日(星期五) 10:00-17:00 | EHS 委員會            | 國際會議廳303會議室   |
| 9:00-12:00             | PI&C委員會            | 國際會議廳302會議室   |
| 13:00-17:00            | I&C委員會             | 國際會議廳203會議室   |

### 關於研討會和招待會的申請

請登錄 SEMICON Japan 的官方網站進行申請。

[www.semiconjapan.org](http://www.semiconjapan.org)

#### 收費研討會

確認申請之後,我們將立即發送申請確認郵件。請列印之後攜帶前往研討會受理處 (幕張國際展覽中心 國際會議廳 2F)。

#### 付款方式:信用卡或銀行匯款

取消:自申請之日起 10 天以後或 11月26日(星期六)以後不接受取消或變更。請派出代理人出席。萬一發生缺席情況,恕不退還任何申請費用,敬請諒解。

當天申請:只有在各研討會未滿員的情況下才可在當天申請。

學校相關方 (包括學生) 優惠價格:每個研討會或每個 STS1 會議 3,500 日元 (含消費稅)

#### 免費研討會申請

事先申請:網站預約制。我們將立即發送申請確認郵件。請列印之後攜帶前往會場前受理處。免費研討會的事先申請不保證有座位。請儘早到達現場。

當天申請:只有在各研討會未滿員的情況下才可在當天申請。

#### 聯繫方式

SEMICON Japan 活動接待處 (週一到週五 9:00-17:30)

電話: 03.3222.5993 傳真: 03.3222.5790 Email:

[jeventinfo@semi.org](mailto:jeventinfo@semi.org)

## 展會入場方式

SEMICON Japan 的入場方式為預約制。

展會入場預約請至 [www.semiconjapan.org](http://www.semiconjapan.org)

### 如何收到您的入場證

如果您在 11 月 22 日之前登記，且您不是日本居民，敬請于到達現場時前往“海外登記處”獲取您的入場證。

請隨身攜帶一份確認電子郵件。

如果您是日本居民，您將在郵件中收到您的入場證。

如果您在 11 月 22 日或之後登記，日本居民或非日本居民應于“海外登記處”現場獲取入場證。

請隨身攜帶一份確認電子郵件。

對預約登記的諮詢請至 <http://semi.jp.sj>

## 交通指南

**會場地址：**幕張國際展覽中心 郵編 261-0023 千葉市美浜區中瀬 2-1 電話：043.296.0001（總機）  
詳情請前往幕張國際展覽中心網站（[www.m-messe.co.jp](http://www.m-messe.co.jp)）瞭解。

**乘坐電車時（數位為花費時間）** \*花費時間可能因時間段不同而不同。

### ▶ 海濱幕張站（JR 京葉線快速）



### ▶ 幕張本郷站（JR 總武線）



## 巴士指南

### 往返

- 橫濱市區航站中心 ↔ 幕張國際展覽中心 收費高速班車（發車間隔約 20~60 分鐘，僅橫濱發車可事先預約）
- 成田機場 ↔ 海濱幕張站周邊酒店 收費高速班車（發車間隔約 40~60 分鐘）
- 羽田機場 ↔ 幕張國際展覽中心 收費高速班車（發車間隔約 10~40 分鐘）

### 單程

- 幕張國際展覽中心始發至東京站方向 收費直達班車（下午發車，發車間隔約 20~30 分鐘）
- 幕張國際展覽中心始發至津田沼站方向 收費班車（下午發車，發車間隔約 30 分鐘）

## 自駕車前來時

- 從東京市中心、羽田方向出發約 40 分鐘。從習志野 IC（東關東汽車車道）或幕張 IC（京葉道路）出發約 5 分鐘。
- 從成田機場出發約 30 分鐘。從灣岸千葉 IC 出發（東關東汽車車道）出發約 5 分鐘。